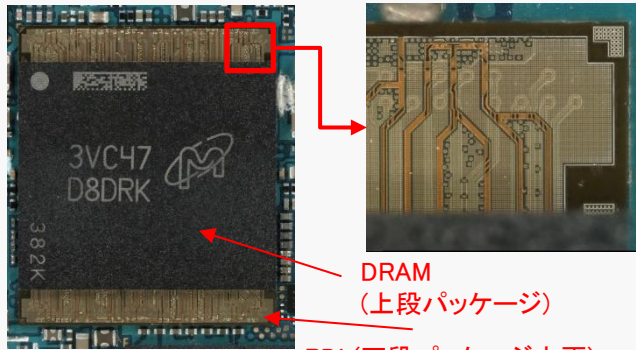


## プロセッサ: Samsung Galaxy S24 Exynos 2400 FOWLP構造比較レポート



Galaxy S24外観

引用 <https://mobilelabz.net>



Exynos2400 パッケージ

型番: Galaxy S24  
製品リリース日: 2024年1月31日

### 概要

Exynos 2400にはSamsungが独自開発したFOWLP (Fan Out Wafer Level Package) 技術が採用されました。本レポートではExynos2400のパッケージ構造をまとめ、断面構造からSamsungが独自開発したFOWLP技術のプロセスフローの推測を行うとともに、対抗製品であるiPhoneに採用されたTSMCのFOWLP技術(A16:一部抜粋)との比較を行った。

### 製品特徴

- ・Exynosシリーズで初めてのRDL(再配線)を用いたFO-WLP採用
- ・POP下段のパッケージ上面にもRDL(再配線)が形成されており、POP上段のパッケージの端子をRDLで受けるように設計することでPOPの上段パッケージを自由に選性できるようになっている。(AシリーズはPOPの上段パッケージを選ぶ際に下段パッケージの構造による制約がある)

### 解析内容

- 1)パッケージ外観+X線像(外観とX線像を取得)
- 2)断面解析(パッケージの断面構造が分かる情報を取得)
- 3)EDX分析(パッケージの断面から構成部材について元素分析【点分析】を実施)
- 4)Aシリーズ(POP構造)との比較
- 5)RDL下面の各層平面像取得

### レポート価格

価格: ¥500,000(税抜) 納期: 受注後 1weeks

※A16についてのレポートも弊社で作成しています。ご興味ございましたら問い合わせをお願いします。

## 目次

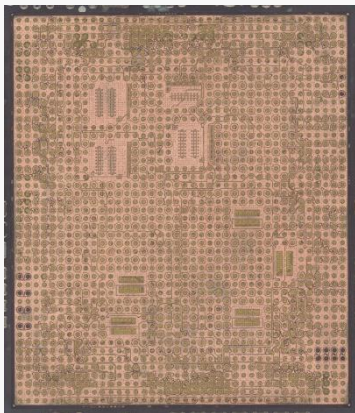
	Page
1. Summary	・・・ 3
2. 外観観察	・・・ 8
3. 断面OM観察	・・・ 11
4. 断面SEM観察	・・・ 19
5. SEM-EDX分析	・・・ 25
6. 各層除膜	・・・ 32



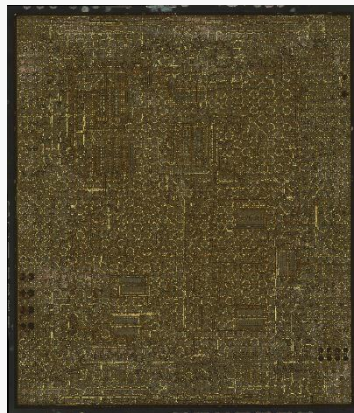
## 構造解析レポートからの抜粋



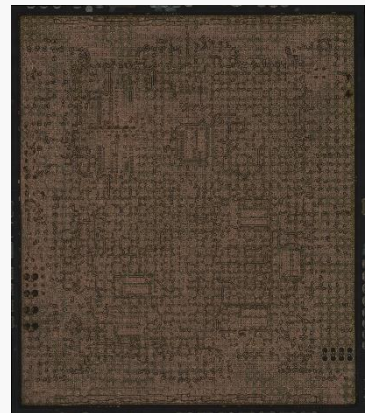
Exynos2400 プロセスフロー(推測)



L4



L3-L4



L3

Exynos2400 各層除膜写真(L4/L3-L4/L3)